

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临2025-031

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日上午11:00-12:00通过价值在线路演中心（网址：<https://www.ir-online.cn/>）以网络文字互动的方式召开了2025年第三季度业绩说明会，针对公司2025年第三季度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在遵循信息披露规则的前提下，就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2025年10月28日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：临2025-030），并向广大投资者征集大家所关心的问题。

公司于2025年11月4日上午11:00-12:00，通过价值在线路演中心（网址：<https://www.ir-online.cn/>）以网络文字互动的方式召开了2025年第三季度业绩说明会。公司董事长兼总经理王蔚先生、董事会秘书兼财务总监段佳国先生、独立董事刘海燕女士出席了本次说明会，针对公司2025年第三季度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在遵循信息披露规则的前提下，就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题1：你好，公司前三季度利润虽然同比保持良好增长，单季环比却出现停滞，但同类型封测公司却可以继续保持大幅度增长，离不开先进封测和AI芯片

等需求的大幅度增长，想问一下：1.目前公司主要的CIS封测业务发展是否遇到了瓶颈？2.贵公司投资visic公司已有多年，是否考虑在中国落地生产，打造海外研发+中国生产的产业模式？2.公司是否考虑像华天科技那样通过兼并，补足公司在AI芯片领域封测的短板？

回答：您好，不存在您说的发展瓶颈，随着AI及各项智能化应用的快速发展，CIS作为智能化终端视觉感知系统的核心构成，各项新的应用层出不穷，如智能驾驶、AI眼镜、机器人等等，因此在智能化快速迭代发展的大趋势下，CIS市场将随之迎来快速发展机遇。公司作为全球传感器领域先进封装技术的领先者，在技术创新、生产能力、市场与客户等方面具备显著优势，也将受益于此发展趋势；关于公司投资的以色列VisIC公司业务情况，请您详见前述回复；公司专注于集成电路先进封装技术服务，为晶圆级TSV先进封装技术的领先者。随着AI算力、存储等产业的快速发展，对TSV为代表的先进封装技术的需求与创新能力显著提升，公司将通过发挥核心技术竞争能力，聚焦市场与产业需求，积极推进技术创新与市场客户拓展，把握不断发展的产业与市场机遇。

问题2：公司第三季度营收和利润增长强劲（营收同比增长35.37%，净利润同比增长46.37%）。请问增长的主要驱动因素是什么？公司对全年业绩有何展望？

回答：随着汽车智能化的快速发展，单车摄像头搭载数量和价值量不断提升，驱动车规CIS芯片市场需求呈现显著增长趋势，公司作为全球车规摄像头芯片晶圆级TSV封装技术的领先者，在车规CIS领域的封装业务规模与技术领先优势持续提升。与此同时，公司也在不断拓展新的应用市场，一方面在CIS领域，随着AI眼镜、机器人等终端市场的发展，公司在相关领域的业务规模呈现增长趋势；另一方面在非CIS领域，公司有效拓展MEMS、FILTER应用市场，量产规模也在逐步提升。感谢您的关注！

问题3：马来西亚槟城生产基地目前的具体建设进度如何？是否存在影响工期的因素？该基地明年的量产计划与客户导入情况是否顺利？

回答：目前马来西亚槟城生产基地已完成土地厂房的购买事宜，正在推进无尘室的设计与建设工作，各项工作均按照预计进度有效推进。

问题4：鉴于先进封装的运用领域逐渐拓展，公司除了传感器领域的布局，是否还有在其他可能领域，如逻辑芯片、存储芯片领域拓展业务，扩大公司的收入范围。目前公司对于功率芯片的业务拓展进展如何，预计何时能够给公司带来显著的业绩增长。

回答：随着AI技术的快速发展，AI芯片、自动驾驶、AI手机等应用场景呈现快速增长趋势，对先进封装技术的创新与服务能力不断提出新的需求。AI芯片包含大量的计算核心，需要封装技术在有限空间提供高密度互联方案，如通过TSV 硅通孔技术实现芯片的堆叠、光电共封、光电互联等。公司作为晶圆级TSV封装技术的引领者，一直在密切关注产业动态与市场需求，积极推进技术能力的创新开发与项目拓展。公司投资的以色列VisIC公司为全球领先的第三代半导体GaN（氮化镓）器件设计公司,正在积极开发基于硅基氮化镓技术的400V//650V/800V等逆变器方案，其D3GAN技术具有导通电阻低，开关频率高，损耗小，可靠性高等特点。目前VisIC公司一方面聚焦车用逆变器领域，积极和知名汽车厂家或TIE1厂商进行芯片及模块设计的合作，全力推进相关产品的规模化应用；另一方面围绕人工智能与数据中心快速发展的市场需求，积极进行产品开布局，以期能为人工智能密集型数据中心提供高功率、低损耗、高可靠的功率模块产品方案；关于功率芯片业务的发展情况，请您见前述回复。

问题5：您好！请问公司牵头的国家重点研发计划“MEMS传感器芯片先进封装测试平台”项目，在晶圆级键合、垂直互连等核心技术上是否取得实质性突破？项目针对的图像传感器、陀螺仪、压力传感器等产品的封装工艺是否已形成成套技术方案？相关技术是否开始推进商业化量产或行业服务落地？盼复，谢谢！

回答：您好，该项目为公司牵头承担的国家重点研发计划项目，项目针对高端MEMS传感器先进封装测试需求，建立基于标准的面向图像传感器、硅麦克风、加速度计、陀螺仪、压力传感器、红外传感器、流量传感器等高端传感器的先进封装测试公共服务平台，目前项目技术工艺开发、客户拓展、商业化应用均在有序推进实施。

问题6：董秘您好，请问公司在晶圆级TSV封装技术、3D堆叠集成等核心技术上，相较于竞争对手有哪些独特的优势？近期在HBM技术相关的封装工艺研发上取得了哪些具体进展？

回答：公司作为专注于集成电路先进封装技术，尤其在晶圆级TSV封装技术领域，公司在技术创新、生产能力、市场地位与核心客户等具备显著竞争优势；关于内存堆叠等新的应用市场拓展，请详见前述回复，感谢您的关注！

问题7：您好，公司在荷兰拥有光学器件研发和制造工厂，荷兰子公司的运营是否受到当地政策变化的影响？公司如何保障全球供应链的稳定？在海外市场拓展方面，有哪些新的战略布局？

回答：您好，公司荷兰子公司生产经营一切正常，没有您所提到的相关影响；面对当前国际贸易与全球产业重构发展趋势，公司将会持续推进全球化发展战略，积极融入全球产业链新的分工协同，巩固提升产业地位，努力实现国内、外的循环协同发展。

问题8：您好！公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司此前终止减持计划，后续是否有调整股权比例的规划？此外，公司是否存在引入战略投资者或股权合作的相关安排？

回答：您好，公司股东根据自身经营情况所需做出相应安排，与公司经营情况没有关系；公司管理团队专注公司经营管理，通过技术自主创新、业务与市场拓展、全球先进技术并购整合等内生、外延方式，推进公司业务规模、盈利能力的持续健康发展，感谢您的关注！

问题9：公司账面存在25个多亿的现金，基本是24年收入的2倍，公司的股东回报率这么低？而且是持续几年均是如此，公司保留这多现金的原因是什么？

回答：您好，公司专注主业经营，具备良好的盈利与现金流能力水平、资产质量与结构良好，这些一方面是公司竞争能力的体现，同时也是公司持续发展的坚强后盾，从而保障公司技术的持续创新开发、海外生产基地有效建设、国际化产业与技术并购整合的有序推进，感谢您的关注。

问题10：公司有cpo相关的业务吗

回答：CPO光学共封技术随着光纤模块传输速率的不断提高和硅光技术的逐步发展越来越成为新的技术方向，其使用了目前半导体CMOS工艺和其他晶圆加工工艺以实现光连接代替电连接。公司拥有晶圆级封装技术和晶圆级光学加工能力等技术优势，并密切关注该产业发展趋势，积极推进技术工艺能力提升与项目开展。

问题11: 1、公司目前产能利用率如何, 现有产能能否满足市场需求。2、公司第三季度毛利率提升比较大, 能否介绍下具体原因, 相关趋势是否具有延续性。3、公司能否展望一下明年的市场需求情况。4、公司是否有新的业务拓展规划。

回答: 公司目前产能利用状态良好, 并通过生产能力的有效提升, 满足客户与市场需求; 随着公司技术持续的创新迭代、业务规模的增长、业务产品结构的变化, 公司毛利率呈现上升趋势; 随着智能化应用场景的快速发展, CIS作为智能化应用视觉感知系统的核心, 智能驾驶、AI眼镜、机器人等新的应用快速发展, 将驱动CIS市场随之迎来快速发展机遇; 公司专注于集成电路先进封装技术服务, 聚焦全球传感器细分市场, 公司将通过技术工艺的持续创新开发, 一方面把握传感器市场在智能化趋势下的快速发展机遇, 另一方面不断拓展新的业务应用领域, 不断提升FILTER、MEMS等领域业务规模, 顺应AI产业发展趋势对TSV为代表的先进封装技术的创新需求, 积极推进技术创新开发与项目拓展。

问题12: 请问王总, 目前贵司的产能情况如何? 哪些封装业务方面处于产能饱和状态? 海外的新产线目前进度如何, 是否能提前投产? 最后, 针对目前算力相关的内存芯片, 贵司是的已经有相关的封装业务产生效益?

回答: 您好, 公司目前产能状态良好, 尤其随着汽车智能化的快速发展, 公司车规CIS的封装业务的生产能力与业务规模持续提升; 为有效应对全球产业链的重构发展, 公司积极布局海外生产基地建设, 目前相关工作均在按照规划有序推进; 公司一直高度关注AI发展所带来的新市场趋势, 如您所提到的内存市场对TSV 硅通孔技术也在不断提出新的创新要求。公司作为晶圆级TSV封装技术的引领者, 在积极推进技术能力的创新开发与相关项目的拓展。

问题13: 公司大股东近些年连续减持, 公司股价长期低于板块和同类型公司, 公司有没有考虑过引进战略投资者, 改变目前的现状?

回答: 请见前述回复, 谢谢!

问题14: 公司在马来西亚的工厂进展如何? 未来主要服务于那些客户, 预计对于营收的贡献会是怎样?

回答: 请见前述回复, 谢谢!

问题15: 请详细介绍一下MEMS, 和Filter领域的进展, 应用领域, 趋势

回答: 请见前述回复, 谢谢!

三、其他事项

关于本次业绩说明会的具体内容，详见价值在线路演中心（网址：www.sse.com.cn）。

感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 日